

國立臺灣大學 書函

機關地址：10617 臺北市羅斯福路4段1號

聯絡人：張芝云

電話：(02)3366-3269

傳真：(02)2363-2554

電子郵件：chihyun@ntu.edu.tw

受文者：如行文機關

校內電子文

發文日期：中華民國106年2月15日

發文字號：校研發字第1060011088號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：科部產字第1060009984號、科技部產學研發聯盟合作計畫說明會、A_106年產學研發聯盟合作試辦計畫徵求說明、企業之合作約定書、聯盟推薦計畫證明文件

主旨：檢送科技部公開徵求106年「產學研發聯盟合作計畫」半導體領域試辦計畫相關資料1份，自即日起接受申請，校內截止期限請依說明二辦理，逾期未送達或線上申請資料不全者，歉難受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依據科技部106年2月10日科部產字第1060009984號函辦理。
- 二、欲申請計畫者請於即日起至106年3月27日(星期一)下午5時前完成科技部線上申請作業，並於106年3月28日(星期二)中午12時前填具本校「專案申請科技部補助專題計畫研究經費申請書」送達研發處研究計畫服務組，俾利校方如期彙整造冊函送。
- 三、科技部特定於2月23日及3月3日舉辦計畫說明會，相關說明會議程及報名資訊如附件。
- 四、計畫徵求公告請詳閱科技部網站(<https://www.most.gov.tw/?1=ch>)公告內容。

正本：登載於本校首頁校園公告、各一二級單位

副本：研究計畫服務組、產學合作總中心

國立臺灣大學

裝

訂

線

國立臺灣大學
統騎縫章

科技部 書函

機關地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：吳清源

電話：02-2737-7279

傳真：02-2737-7619

受文者：國立臺灣大學

發文日期：中華民國106年2月10日

發文字號：科部產字第1060009984號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨（106D2003152.DOCX）

主旨：本部106年「產學研發聯盟合作計畫」半導體領域試辦計畫已於本部

網站公告受理至106年3月31日止，特定於2月23日及3月3日舉辦計畫

說明會，檢送說明會議程及報名資訊一份，請查照。

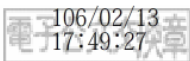
說明：計畫徵求公告詳本部網站(<https://www.most.gov.tw/?l=ch>)公告內

容，請轉知所屬及會員廠商踴躍參加。

正本：專題研究計畫受補助單位（共301單位）、台灣半導體產業協會

副本：本部產學園區司、財團法人國家實驗研究院(產學研發聯盟合作計畫辦公室)

科技部



校級公文 106/02/13



收文號:1060011088

科技部產學研發聯盟合作計畫

計畫說明會

【會議舉辦目的】

科技部因應國家科技、經濟與產業發展之迫切需求，鼓勵國內產業界與學術界組成產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界及學術界結合研發能量，共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，並協助產學界共同培育高階研發領導人才。

為此，106 年科技部公開徵求各大學院校及研究機構，與國內半導體領域產學研發聯盟合作，申請「產學研發聯盟合作計畫」，以協助確保及提升我國半導體產業的國際領先地位與競爭實力。

本計畫已於 106 年 1 月 3 日公告並受理申請，收件截止日期為 3 月 31 日，特此規劃舉辦北部、南部計畫說明會各乙場，與相關申請人詳細說明計畫申請方式及審查重點。

【參加對象】 不限學校教員或廠商代表，免費報名參加。

【會議日期及地點】

◎北部場：106 年 2 月 23 日(四) 14:00~15:30

科技部-科技大樓 2 樓第 12 會議室(台北市大安區和平東路二段 106 號)

◎南部場：106 年 3 月 3 日(五) 14:00~15:30

成功大學光復校區國際會議廳第三演講室(台南市東區大學路 1 號)

【會議聯絡人】

張文馨小姐 TEL:(02)2737-7008、E-mail: wxzhang@narlabs.org.tw

【主辦、執行單位】

主辦單位：科技部產學及園區業務司

執行單位：國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

◎ 報名方式:

採網站報名方式: <https://goo.gl/nTDRUI> (北部場) 、<https://goo.gl/wnF5LV> (南部場)

(主辦單位保留報名席次決定權)

報名時間:各場次人數額滿或會議舉辦日前一天即停止接受報名。

◎ QRcode:



(北部場)



(南部場)

科技部 106 年度產學研發聯盟合作計畫 計畫說明會議程

北部場次會議時間：106 年 2 月 23 日(星期四) 下午 2 時

會議地點：科技部-科技大樓 2 樓第 12 會議室

(台北市大安區和平東路二段 106 號)

時間	議程內容
13:30-14:00	報到與交流
14:00-14:05	致詞
14:05-14:30	計畫內容說明
14:30-15:30	Q&A



科技部 106 年度產學研發聯盟合作計畫 計畫說明會議程

南部場次會議時間：106 年 3 月 3 日(星期五)下午 2 時
會議地點：成功大學光復校區國際會議廳 B1 第三演講室
(台南市東區大學路 1 號)

時間	議程內容
13:30-14:00	報到與交流
14:00-14:05	致詞
14:05-14:30	計畫內容說明
14:30-15:30	Q&A



產學研發聯盟合作計畫 徵求說明

目 錄

壹、背景說明	2
貳、徵求計畫	2
參、審查重點	3
肆、申請辦法及相關資訊	3

產學研發聯盟合作計畫

106 年半導體領域試辦計畫徵求說明

壹、背景說明

我國半導體產業經過三十餘年的發展，已經形成高效率的分工體系，造就舉世知名的半導體兆元產業。在 2015 年，我國晶片（IC）設計業排名世界第二，僅次於美國；晶圓代工與晶片封測業居全球第一；記憶體製造領域排名世界第四，僅次於韓國、美國與日本。以產值計算，半導體為我國最重要之製造業，有多家代表性企業成為全球市場的重要成員，在國內同樣舉足輕重，堪稱是我國經濟發展的火車頭。

在半導體領域的研究方面，同樣在學術界的努力與政府的長期支持下，也具有國際級的研究能量。現今，面對未來科技發展與市場快速成長的契機，還有來自全球競爭對手的嚴峻挑戰，如何透過政府資源的有效運用，進一步鏈結產業界及學術界，共同提升我國半導體產業各領域的競爭力，已成為關鍵課題。

著眼於國家科技、經濟與產業發展的迫切需求，科技部（以下簡稱本部）鼓勵國內產業界與學術界組成產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界、學術界結合研發能量，並共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，以強化產業發展的關鍵技術研發及智財布局，更協助產業界、學術界共同培育高階研發領導人才。為此，106 年本部公開徵求各大學院校及研究機構，與國內半導體領域產學研發聯盟合作，申請「產學研發聯盟合作計畫」，以確保、提升我國半導體產業的國際領先地位與競爭實力。

貳、徵求計畫

一、申請資格

- （一）申請機構（即執行機構）：符合本部補助專題研究計畫作業要點第二點規定者。
- （二）計畫主持人（申請人）及共同主持人：符合本部補助專題研究計畫作業要點第三點規定者。
- （三）產學研發聯盟（下稱聯盟）：其設立宗旨為促進產學合作、推動產業前瞻技術研發。聯盟為計畫申請之推薦機構，確認計畫內容屬於聯盟及業界認可之產業前瞻技術研究。
- （四）合作企業：指符合本部「補助產學合作研究計畫作業要點」第二點規定者。申請本計畫之申請人，須吸引業界提供經費投入研發，並與本計畫之執行重疊一定期間。

二、申請階段及注意事項

- （一）針對我國面臨國際競爭具高度迫切性、具前瞻技術及高階人才需求之關鍵產業，本部

鼓勵籌組產學研發聯盟，106 年以半導體領域先行試辦，並分類為 IC 設計、製造及封測三組。

- (二) 計畫申請書審查：由執行機構檢附聯盟出具之聯盟推薦證明文件（附件一）、申請人與企業之合作約定書（附件二）及計畫申請書向本部提出申請，並說明本計畫與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯。本部得通知計畫申請人到部報告。
- (三) 執行機構應於公告受理期間內向本部提出申請，逾期不予受理。
- (四) 計畫書審查期間自申請文件完整交付之次日起三個月內完成；必要時，得予以延長。審查期間不含補正及陳述意見之期間。
- (五) 本部依審查結果核給補助額度。
- (六) 計畫執行期間自 106 年 8 月 1 起開始執行；申請機構得申請多年期計畫（至多三年），本部將依審查結果決定是否核給分年核定多年期計畫。二年期以上計畫，應於當年計畫結束三個月前線上繳交當年計畫執行之精簡進度報告及完整進度報告以供審核，作為下年度之撥款依據。

參、審查重點

本部得依計畫之領域性質及特色，聘請企業界、學術研究機構、科技行政單位之學者專家，組成審查小組，負責計畫審查，審查作業包括初審書面審查及複審會議審查，如有必要將安排申請人簡報計畫構想及內容。審查重點如次：

- 一、計畫團隊研究群之執行能力、研究主題與目標，企業界之技術需求、所提產業前瞻技術研究之關鍵性、過去執行產學合作計畫之績效、預期研發成果及產業外溢效果等。
- 二、研究項目及經費需求。
- 三、合作企業之資格、研發能力或潛力、出資、承接計畫成果之意願與承諾（包括技術移轉之協議等）及計畫成果之後續研發能力。
- 四、計畫各年及全程之預期績效。
- 五、吸引業界投入經費說明、權利義務規範等文件。
- 六、申請計畫是否包含下列優先補助參考情事：
 - （一）博士研究生或博士後研究人員參與研究計畫者，得作為優先補助之審查參考。
 - （二）業界有吸納計畫內博士班研究生或博士後研究人員誘因相關承諾者，於申請時須一併提供相關證明文件。
- 七、其他審查有關事項。

肆、申請辦法及相關資訊

一、計畫申請書格式及申請辦法

- （一）計畫書請採用科技部專題研究計畫申請書格式，計畫書總頁數須 100 頁以內為原則，

並註明申請組別(IC 設計、製造或封測)。

(二) 自即日起至 106 年 3 月 31 日止，備齊相關資料，逕行上傳本部專題研究計畫補助資訊系統申請，並備函送達本部，文件不全或不符規定者，不予受理。

(三) 計畫審查會議，由申請團隊向審查委員會作計畫簡報說明，詳細時間、地點將另行通知。

二、執行規範：

(一) 本部得補助下列項目所需費用：

1. 業務費：

(1) 研究人力費：

A. 專、兼任助理費用及臨時工資。

B. 博士後研究人員費用；

(2) 耗材、物品、圖書及雜項費用：與本聯盟產學合作計畫直接有關之其他費用等。

2. 研究設備費。

3. 管理費。

(二) 吸引業界投入經費得支應下列費用：

1. 研究主持費：由執行機構、主持人及合作企業共同商議。

2. 業務費：

(1) 研究人力費：專、兼任助理、博士後研究人員等研究人力費用。

(2) 耗材、物品、圖書及雜項費用。

3. 研究設備費。

4. 國外差旅費：出席國際會議差旅費、國外或大陸地區差旅費。

5. 管理費。

(三) 博士後研究人員得因執行計畫需要至合作企業參與研發，其工作內容、期間等相關事項由計畫執行機構以契約明定。

(四) 吸引業界投入經費應高於申請本部補助經費，業界提供經費之計算，得回溯至本計畫當年度徵求公告日當月起至本計畫執行迄日止，且應與本部計畫執行期間重疊一定期間。

(五) 業界提供經費應使用於計畫之執行或與計畫執行相關之事項，不得任意支用。

(六) 博士班研究生參與本計畫之研究人力費用，本部至少補助 1.5 萬元，業界提供經費應有相對額度之投入。另業界承諾額外資助博士研究生每位每月新臺幣 1 萬元以上之獎學金者，除原依規定支領研究計畫兼任助理費用外，得依「科技部鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」，於本計畫補助期間內，每月支領本部專款補助與企業同額之獎學金，惟本部額外專款補助部分以每月 2 萬元為上限，且累計補助金額不受本部補助研究計畫兼任助理費用支給標準表之限制。計畫執行機構得於當年度本部補助經費第二期款項撥款前開立並出具業界資助博士研究生獎學金之證明文件。

(七) 計畫內核給博士後研究人員及博士班研究生經費，如因研究計畫需要，得報經本部同意變更後，於研究人力費內調整運用。

(八) 執行機構應制定研發成果之規範或整體機制，以加強研發成果之管理、推廣及運用，

具體落實推動產學合作之目標。

- (九) 合作企業提供研究經費、撥付管理與使用、申請補助項目、其他與計畫相關之權利義務等，應事先以書面約定。
- (十) 若執行機構未能於當年度本部補助經費第二期款項撥款前開立並出具業界出資證明文件，或計畫之年度目標未能達成，本部將採分期管考方式，當期未達成約定事項者，終止下期以後之補助經費，並納入本部後續補助之參考。

三、產學研發聯盟應規劃並負責下列事項：

- (一) 聯盟之任務應包括媒合及促進產學合作計畫。
- (二) 為確保產學合作計畫之推動，聯盟應制定專屬之產學合作計畫作業、計畫經費管理，以及研發成果之管理與運用等相關規範或整體機制，以具體達成產學合作計畫推動目標，加強研發成果之管理、推廣及應用。
- (三) 聯盟應提出未來關鍵研究主題規劃，規劃範疇及產學合作計畫內容須以產業前瞻技術研究為主。
- (四) 聯盟應確認推薦計畫之內容屬於聯盟及業界認可之產業前瞻技術研究、與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯性等。

四、結案報告

- (一) 計畫結束後三個月內，申請機構應向本部繳交計畫研究成果精簡報告及完整結案報告（電子檔），並將產生之研發成果及對產業技術提升之績效等相關資料，辦理登錄作業，並具體展示。
- (二) 二年期以上計畫，應於當年計畫結束三個月前線上繳交當年計畫執行之精簡進度報告及完整進度報告以供審核，作為下年度之撥款依據。
- (三) 計畫主持人對前二項計畫之精簡報告、完整報告及研發成果實際運用績效登錄等內容，應負完全責任。如因涉及專利、技術移轉案或其他智慧財產權等，而不宜對外公開者，請勿將其列入精簡報告，原則上本部將公開精簡報告。

五、其他未盡事宜請依「科技部補助產業前瞻技術計畫作業要點」及其他相關規定辦理。

六、聯絡方式

科技部產學研發聯盟合作計畫辦公室

聯絡人：卓文琳

電話：02-2737-7848

科技部產學及園區業務司

承辦人：吳清源

電話：02-2737-7279

【○○○○聯盟推薦計畫證明文件】(參考格式)

申請人_____吸引業界_____投入屬產業前瞻技術

研究與開發(合作主題：_____)之研發經費，滿足下列條件：

1. ☐投入經費預計執行期間：自____年____月____日至____年____月____日止

☐投入經費已執行期間：自____年____月____日至____年____月____日止

2. ☐企業承諾出資研發經費

(第一年：_____仟元；第二年：_____仟元；第三年：_____仟元)

☐企業已撥付研發經費

(第一年：_____仟元；第二年：_____仟元；第三年：_____仟元)

3. ☐檢附【申請人與企業之合作合約】

☐檢附【申請人與企業之合作約定書】以茲為證。

依據聯盟作業規範，本聯盟推薦本合作計畫申請科技部補助產學研發聯盟合作計畫。

此致

科技部

聯盟負責人：_____ (簽章)

聯盟印 鑑：_____ (聯盟章)

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日